

证券代码：603330

证券简称：天津新材

公告编号：2026-025

天津新材（上海）科技股份有限公司

关于 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月29日通过价值在线（www.ir-online.cn），以视频及网络互动方式召开了2025年度暨2026年第一季度业绩说明会。现将本次说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会于2026年5月29日15:00-16:00以视频及网络互动方式在价值在线（www.ir-online.cn）召开。

公司董事长兼总经理茹正伟先生、副总经理/董事会秘书耿文亮先生、财务总监路赟女士、独立董事陈来鹏先生，证券事务代表兼投资总监卢志军先生出席了本次说明会，就公司2025年度暨2026年第一季度的经营成果、财务状况、发展战略等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及相关回复情况

公司通过价值在线（www.ir-online.cn）就投资者提出的问题进行了回复，主要问题及回复情况如下：

问题一：请问公司有没有参与华为韬T定律的封装材料

答：尊敬的投资者，您好！公司目前没有参与华为韬T定律的封装业务，敬请关注公司相关公告，感谢您的关注！

问题二：贵司年报中披露，电子胶产品已经成功进入半导体行业，具体有什

么进展？

答：尊敬的投资者，您好！公司电子胶板块光模块透镜固定用胶、底填胶等产品已经进入半导体及汽车电子领域小批量供货，因产品导入验证周期等原因，目前该部分业务占电子胶总体营收比重较低，不会对公司业绩造成重大影响，具体信息请关注公司公告。感谢您的关注！

问题三：贵司未来的发展方向是什么？电子胶在未来的规划中投资占比多少？

答：尊敬的投资者，您好！公司电子胶相关业务占公司总营收约20%，根据公司战略，电子胶黏剂和中高端热熔胶粘剂作为公司未来发展重点，后续将继续围绕热熔胶、电子胶等主业，逐步加大高端胶黏剂产品的研发投入，加快新能源汽车、半导体等战略新兴领域客户的开拓速度，具体信息请关注公司公告，感谢您的关注！

问题四：请问公司后续是否有引入战略投资者、开展并购整合或拓展新业务的规划？整体未来发展方向是如何定位的？

答：尊敬的投资者，您好！公司自成立以来，始终坚持在新型环保粘接材料领域深耕发展，拥有20余年的高分子材料合成、改性经验，未来公司将聚焦主业，在巩固现有市场的同时，加速高端胶黏剂产品研发，持续拓展新能源汽车、半导体等战略新兴领域。公司将根据未来战略发展需要，充分利用上市公司平台资源，持续拓展新业务、新领域。具体信息请关注公司公告。感谢您的关注！

问题五：贵公司在高端半导体封装材料赛道有什么产品可以供货？

答：尊敬的投资者，您好！公司电子胶业务经过多年发展、沉淀，积累了大量高端胶黏剂产品开发和客户服务经验，目前公司已经开发光模块透镜固定用胶、高导热胶、导电胶、底填胶等产品，目前该部分业务占电子胶总体营收比重较低，不会对公司业绩造成重大影响，感谢您的关注。

问题六：贵司目前电子胶产线的利用率有多高？针对目前的市场需求，贵司有扩充产线的计划吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司电子胶业务2025年度的产能利用率为58.7%。

未来将根据业务发展需要，适时进行相关产能规划，具体信息请关注公司公告，感谢您的关注！

问题七：贵公司此前提到向半导体/汽车电子/储能导热三大赛道转型，目前这些新业务的进展如何？订单情况、客户验证进度、产能规划分别处于什么阶段？预计何时能形成规模化收入贡献？

答：尊敬的投资者，您好！公司电子胶板块光模块透镜固定用胶、底填胶等产品已经进入半导体及汽车电子领域小批量供货，因产品导入验证周期等原因，目前该部分业务占电子胶总体营收比重较低，不会对公司业绩造成重大影响。未来公司将持续拓展新能源汽车、半导体等战略新兴领域，加大新产品研发力度。后续相关业务进展等具体信息请关注公司公告，感谢您的关注！

本次说明会具体情况详见价值在线 (<https://www.ir-online.cn/>)。感谢各位投资者的热情参与，公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心的感谢。

特此公告。

天津新材（上海）科技股份有限公司

2026年5月30日